

## 日月光九十九年度第三季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 99 年 10 月 29 日同步於美國及台灣兩地發佈九十九年度第三季及前三季獲利報告，本公司九十九年第三季之合併營業收入較九十九年第二季成長 11%，較九十八年同期成長 104%，為新台幣 51,489 百萬元。茲將日月光九十九年度第三季單季及前三季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	99 年度 第三季	99 年度 第二季	98 年度 第三季	99 年度 前三季	98 年度 前三季
營業收入	51,489	46,416	25,205	135,460	59,483
營業毛利	11,105	9,916	6,403	28,577	11,649
營業淨利(淨損)	6,665	5,763	4,013	16,707	5,162
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	6,475	5,383	3,857	15,932	4,416
所得稅利益(費用)	(771)	(611)	(558)	(1,838)	(1,066)
少數股權純損(益)	(244)	(159)	(112)	(626)	(55)
本期淨利(淨損)	5,460	4,613	3,187	13,468	3,295
稀釋每股盈餘(元)	0.91	0.76	0.56	2.24	0.58

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	99 年度 第三季	99 年度 第二季	98 年度 第三季	99 年度 前三季	98 年度 前三季
營業收入	34,015	31,697	25,205	93,135	59,483
營業毛利	9,103	8,303	6,403	23,853	11,649
營業淨利(淨損)	5,890	5,367	4,013	15,075	5,162
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	6,211	5,176	3,857	15,319	4,416
所得稅利益(費用)	(596)	(525)	(558)	(1,517)	(1,066)
少數股權純損(益)	(155)	(38)	(112)	(334)	(55)
本期淨利(淨損)	5,460	4,613	3,187	13,468	3,295
稀釋每股盈餘(元)	0.91	0.76	0.56	2.24	0.58

### 半導體封裝測試營運

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	48
個人電腦	16
汽車及消費性電子產品	36
其他	0
前十大客戶佔營收比重	44

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	54
歐洲	14
台灣	18
日本	9
亞洲其他地區	5

封 裝 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
Advanced substrate & leadframe based	84
Traditional leadframe based	8
Module assembly	5
Others	3
封裝資本支出金額	185 百萬美元
打線機台數	11,467 台

測 試 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	85
晶圓測試	13
前段測試	2
測試資本支出金額	72 百萬美元
測試機台數	2,060 台

### 環隆電氣之產品結構及客戶組成

產 品 結 構	占營收比率(%)
微電子構裝技術暨製造服務	20
電腦暨週邊產品	13
通訊產品	37
網路儲存暨伺服器產品	10
工業暨汽車電子產品	20
前十大客戶佔營收比重	78
EMS 資本支出金額	8 百萬美元